



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20080125000

2008 年 2 月 9 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 ビジネスオペレーションズ部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎 (牧)SOIC 8pin Dパッケージ一部製品 組立サイト追加変更予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願ひ申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	■Initial notice (Plan)		□Final notice	
変更概要	Design/Specification	□Design	□Electrical	□Mechanical
	Wafer Fab	□Site	□Process	□Material
	Wafer Bump	□Site	□Process	□Material
	■Assembly	■Site	□Process	□Material
	Test	□Site	□Process	
	Others	□Packing/Shipping/Labeling		□ -
変更内容	SOIC 8pin D パッケージ一部製品 組立サイト追加変更 現行：CARSEM 社(マレーシア) 変更後：CARSEM 社(マレーシア)及び TI-Mexico			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	5 月下旬の出荷より予定しています。 (サンプルに関しましては、3 月 6 日以降となります。)			
品質認定試験	■計画		□終了	
製品表示	□変更無し		□変更あり	
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。
最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、本PCNの更新版として捺印変更、認定試験の結果を含め、変更品の出荷に先立つ30日以前に、変更通知の発行をもって連絡させていただきます。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) SOIC 8pin Dパッケージ一部製品について、現行、CARSEM社(マレーシア)にて製造いたしておりますが、これに加えTI-Mexicoでの製造を追加し認定する予定です。この変更に伴い、一部部材の変更が発生しますが、共に既に量産に適用されている部材になります。尚、出荷梱包部材につきましては、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。

変更項目	現行	変更後
組立サイト	CARSEM社(マレーシア)	CARSEM社(マレーシア) TI-Mexico
マウントコンパウンド	ABLESTIK 8290	ABLESTIK 8290 QMI505MT
モールドコンパウンド	SUMITOMO G600C	SUMITOMO G600C GR825-73B

理由：供給能力の確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
UCC2837D	UCC284DP-5G4	UCC29411D	UCC3837DG4	UCC39413DG4
UCC2837DG4	UCC284DP-ADJ	UCC29411DG4	UCC3837DTR	UCC3946D
UCC2837DTR	UCC284DP-ADJG4	UCC2946D	UCC3837DTRG4	UCC3946DG4
UCC2837DTRG4	UCC284DPTR-5	UCC2946DG4	UCC39411D	UCC3946DTR
UCC284DP-12	UCC284DPTR-5G4	UCC2946DTR	UCC39411DG4	UCC3946DTRG4
UCC284DP-12G4	UCC284DPTR-ADJ	UCC2946DTRG4	UCC39412D	
UCC284DP-5	UCC284DPTR-ADJG4	UCC3837D	UCC39413D	

信頼性試験

信頼性試験計画

信賴性試驗計畫				
信賴性試驗期間	開始	2007 年 9 月	終了	2008 年 4 月
信賴性試驗 – 試料構成詳細				
Device	UCC281DP-ADJ	Die Rev/ Size (mils)	A / 80 x 120	
Wafer fab Site	SHE	Technology	Bi-CMOS	
Fab Process	IMP-PWR1			
Assembly Site	MEX	Package / Pin	D / 8	
Mount compound	QMI-505MT	Mold Compound	GR825-73B	
Lead Composition/ Finish:	Cu / NiPdAu			
信賴性試驗計畫				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample size	
** Steady-state Life Test	150C, 300hrs		116	
** Biased HAST	130C/85%RH, 96hrs		77	
** Autoclave 121C	121C, 96hrs		77	
** T/C -65C/150C	-65/150C, 1000cys		77	
** Thermal Shock	-65/150C, 1000cys		77	
** High Temp. Storage Bake	150C, 1000hrs		77	
ESD HBM	2000V		3	
ESD CDM	500V		3	
Side by side Electrical Char.	Full Temperature		30	
Manufacturability	Per mfg. Site specification		-	
Note: ** Preconditioning required I2/260C				